

## 崇达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上业绩交流会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	广东恒健国际投资有限公司、东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东坤资产、广东大兴华旗资产管理有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、北京泰德圣投资有限公司、中国人保资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、昭华（三亚）私募基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司、长城证券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、上海森锦投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、华安证券股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司等机构。 （注：接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。）
时间	2024年4月15日
地点	广东省深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：余忠 董事、副总经理：彭卫红 财务总监：赵金秋
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司主要经营情况说明：</b></p> <p><b>1、关于收入：</b>根据 PrismaMark 报告，2023 年全球 PCB 市场产值为 695 亿美元，同比下降 15%，下滑幅度是 2012 年以来最为严重的一年。</p> <p>2023 年，总体市场方面，在面临行业内外诸多困难和挑战背景下，公司经营管理层通过不懈努力，业绩总体保持平稳运行。2023 年度，公司实现 57.72 亿元收入，同比下降 1.68%，总体处于行业较好水平。</p>

**2、关于净利润：**2023年，公司实现归母净利润4.09亿元，同比下降35.84%，净利润下滑的主要原因：

(1) 资产减值损失增加8,273万元，主要为存货减值损失增加8,890万元，受市场行情影响，公司应用于通讯、手机的PCB产品单价下降，公司基于谨慎性原则，严格按照会计准则要求计提相应存货减值。

(2) 销售费用同比增加4,626万元，主要是公司2023年度持续加大销售策略：完善销售人员激励机制、引进优秀销售人才、加大海外客户出差拜访，销售费用同比提升。

(3) 财务费用同比增加4,607万元，主要是汇率波动导致2023年度汇兑收益减少5,777万元。

(4) 公司收购的控股子公司普诺威受行业景气度影响，IC载板市场需求下滑，普诺威净利润同比下降6,036万元，对公司归母净利润影响金额为2,924万元。

**3、关于2023年度现金分红：**2023年度的利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元，根据目前公司总股本测算，本次现金分红总额占2023年度归母净利润的53%。公司上市后连续的现金分红比例保持在50%左右，以持续稳定的现金分红积极回报投资者。

**4、关于2024年一季度经营情况：**根据Prismark报告，随着去库存进展持续，2024年市场需求预计将得到一定程度的复苏，2024年全球PCB市场产值为730亿美元，同比增长5%。

受行业周期性波动影响，目前面向通讯、服务器的高多层板，以及子公司的IC载板等市场需求和价格持续在恢复。公司具有较强的产品、成本和价格竞争力，2024年公司将继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的大客户销售策略，加大海外订单的导入，加强销售团队建设，为快速填满新开工厂产能做好准备。

2024年第一季度业绩具体详见公司将于2024年4月27日披露在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

## 二、主要问答：

### 1、公司目前产能利用率如何？

公司目前整体产能利用率85%左右，深圳工厂、江门工厂受部分订单影响，目前产能和产品交期较紧张。

## 2、公司拟海外投资 10 亿，是怎么考虑的？是否有订单支持？

2023 年度，公司海外销售收入占比 57%，且销售毛利率高于国内市场，在 2023 年度行业景气度大幅下滑的背景下，海外销售毛利率同比上升了 2.37 个百分点。公司在海外市场具有较强的产品、成本和价格竞争力，公司为积极开拓海外订单，保持公司在海外领域的长期竞争优势，同时响应现有海外客户需求，拟投资不超过 10 亿元，通过并购或自建厂房等方式尽快完成海外投资，完善产品在全球市场的供应能力。

## 3、公司未来是否有股份增持或回购计划？

公司如有相关情形将及时履行信息披露义务。公司管理层坚定看好公司长期发展，大股东自上市以来从未进行过减持，大股东和管理层会努力实现经营目标，以良好的业绩来回报全体投资人。

## 4、珠海二期目前进展如何？珠海二厂什么时候投产？

珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司 2022 年非公开发行股票的募投项目，两座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。珠海二厂目前在加快机器设备进厂调试验收等系列工作，预计于 2024 年第二季度试产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应用于通讯等领域。投资者也能通过公司年报看到珠海崇达一厂的经营情况，23 年度珠海崇达收入 8.0 亿元，利润 1.34 亿元，珠海崇达在 49 寸大拼板技术方面取得全面突破，在先进智能制造等方面达到行业领先水平，珠海二厂也将复制珠海一厂的工艺路径，快速实现新工厂的盈利。

## 5、请问现在公司成为华为供应商了吗？进入其产业链了吗？

公司暂未与其直接合作，但通过华勤等 ODM 厂、京东方等客户，长期供应其手机、平板电脑、无线耳机相关的 HDI、FPC 产品。公司将继续保持沟通交流，在适当时机与其直接合作。谢谢！

## 6、公司 2023 年存货减值较大的原因？

公司 2023 年存货减值损失增加 8,890 万元，主要是市场竞争加剧，产品单价下降，基于谨慎性原则，公司按照会计准则要求计提相应存货减值，按成本与可变现净值孰低原则计提。同时考虑库存时间及影响，目前对发出商品及库存商品等库存时间超过 6 个

月的，计提存货减值。

**7、发展人工智能是未来发展的大趋势，AI 服务器及 GPU 等相关的 PC 应用产品市场也会大幅增长，公司目前相关市场布局和研发情况如何？**

公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley 平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台以及其他 AI 服务器 PCB 产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等，具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于 2024 年第二季度投产，将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。

公司持续加大服务器领域的研发投入，2023 年 11 月 23 日，广东省高新技术企业协会官网公示了《2023 年广东省名优高新技术产品名单》，公司的“服务器用高多层印制电路板”产品，凭借科技创新能力突出、技术先进、质量可靠、对产业发展的高价值影响等综合优势，成功获评为“2023 年度广东省名优高新技术产品”。

**8、汽车电子目前客户导入情况如何？汽车电子订单预期怎样？**

汽车电子方面，公司目前主要有松下（Panasonic）、普瑞均胜、泰科电子（TE Connectivity）、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳（LG Magna）等客户，产品主要应用在电子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。

公司在品质、交期、成本等方面具有较强的综合竞争优势，公司将持续为客户创造价值。根据与客户的沟通及自身汽车电子产能释放进度，预计 2024 年汽车电子订单能有较快增长。

**9、子公司三德冠目前业绩是否好转？**

三德冠通过积极完善生产工艺和销售渠道，与国产品牌共同发展，经营能力持续改善，目前根据客户需求持续交付应用于 Mate 系列、X5 折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。受客户新手机、平板电脑等产品需求影响，目前月产品出货量持续提升，盈利能力持续改善。

公司会继续加大对三德冠在生产技术、管理经验、采购渠道、客户资源等方面支持，以加快三德冠经营效益的改善。

### 10、子公司普诺威的先进封装基板进展如何？

**关于新产能：**控股子公司普诺威专注于 BT 载板产品的研发生产，在深耕 MEMS 类载板市场的基础上，依靠多年累积的客户资源和产品经验，完成传统封装基板向先进封装基板的转型，投资 4 亿元新建了 m-SAP 制程生产线，主要聚焦于 RF 射频类封装基板、SIP 封装、电源模块管理、光通讯等细分领域市场。2022 年第四季度，SIP 封装基板事业部一期产线成功通产，二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产，目前产能正在爬坡中。针对 m-SAP 线的产品，普诺威正集中力量开发封装类半导体公司，目前已经完成华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证，并进入日月光半导体、诺思等供应商序列，其他客户正在同步开发中。

#### 关于经营情况变化：

根据 Prismark 报告，2023 年封装基板市场整体下滑严重（-28.2%），主要是因为需求疲软、库存高企、价格侵蚀严重，其整体需求于 2023 年上半年见底，下半年逐步环比改善。随着 2024 年库存和需求改善，以及与 2023 年低基数相比，封装基板预计将成为 2024 年 PCB 市场增长最强劲的领域，增长率为 8.6%。

目前客户库存和需求持续改善，普诺威一季度的 IC 载板产品需求恢复速度加快，订单快速恢复、盈利能力持续改善。

珠海崇达三个工厂目前的情况详见下图：



附件清单（如有）